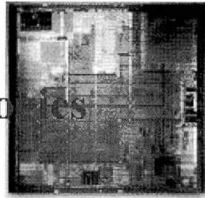


이오넥스·VMTS, 메이저 아성 ‘도전’ WCDMA는 물론 HSDPA까지 넘봐

EoNex Technologies



세계 휴대폰 생산량은 연간 7억대를 돌파했으며, 이 중 국내 업체에 의한 생산이 2억대에 달한다. 올해만 보더라도 삼성이 1억대, LG가 5000만대, 팬택계열이 3000만대 정도 실적을 거둘 것으로 예상되며 일부 중견업체 물량까지 포함한다면 2억대는 족히 될 것으로 추정된다.

국내 업체들이 세계 휴대폰 시장을 주도하는 가운데 그동안 해외 반도체들의 전유물로 여겨졌던 베이스밴드칩을 국내 두 업체가 개발했으니, 업계에 회자되는 것은 당연한 일.

이오넥스

2000년 4월 설립된 이오넥스는 만 5년의 연륜을 자랑한다. 이미 N1000(CDMA2000 1X지원), N1100(CDMA2000 1xEV-DO지원), N2000(W-CDMA지원), N3000(WCDMA 및 CDMA2000 1X지원) 칩을 발표했다. 때문에 업계에서는 퀄컴에 대적할 수 있는 강력한 CDMA베이스밴드 칩 업체로 이오넥스를 꼽는다.

이오넥스가 발표한 칩 중 N1100과 N3000은 이미 업계가 주목하고 있다.

N3000은 W-CDMA/CDMA2000 1X를 지원하는 제품으로 한국·중국을 비롯한 아시아, 북미

시장용 휴대폰에 적용될 수 있다. 이오넥스에 따르면 이 제품을 개발하는데 투입한 개발비만 해도 360억원이다.

CDMA2000 1xEV-DO를 지원하는 N1100은 암9에 64폴리 지원 특성을 지녀 국내 및 북미 같은 하이엔드 CDMA 시장용 휴대폰을 개발할 수 있다.

이오넥스의 로드맵은 이미 발표된 제품에서 그치지 않는다. 조만간 발표될 제품을 보면 더 쟁쟁하다.

올 4분기 출시 예정인 N1150은 암9에 A-GPS는 물론 MP3, 7메가 카메라 인터페이스, 128폴리, MPEG4/H.264(VGA 30프레임), 3D 그래픽 등 최상위 기능을 지원한다. 이 정도 기능이면 세계 제일을 자랑하는 국내 휴대폰 시장에서도 ‘첨단’을 의심받지 않는다.

국내 휴대폰 시장의 경우 MP3P 기능은 이미 일반화됐으며 최근 각광 받는 것이 128폴리, 500메가 이상의 카메라 그리고 3D 그래픽이다. 이오넥스가 발표코자 하는 N1150은 이 모든 것을 만족시킨다. 이 정도 기능이라면 퀄컴 칩과 어깨를 나란히 할 수 있다는 것이 업계 평가이다.

이오넥스 로드맵에서 또 하나 주목할 수 있는 제품은 내년 2분기 발표될 것으로 예정돼 있는 N4000이다. 이 제품은 주요 기능이 N1150과 동일하지만 최근 업계 화두로 등장한 HSUPA/HSDPA를 지원한다는 것에 초점을 맞출 필요가 있다.

HSDPA(High Speed Downlink Packet Access)는 순방향 최대 14.4Mbps까지 지원 가능한 초고속 통신방식으로 3.5G라고도 불린다. W-CDMA 서비스 활성화의 첨병으로 등장한 이 서비스 방식은 올 하반기 미국의 싱귤러 와이어리스가 세계 최초로 상용화를 진행한다고 알려져 있다. 싱귤러는 올해를 시작으로 내년까지 100여 도시까지 서비스지역 확대 방침을 피력했다. 싱귤러에 이어 일본의 NTT도코모도 내년 HSDPA 서비스 제공을 확산하고 있다.

HSDPA 도입논의가 활발하다면 당연히 등장하는 기술이 ‘HSUPA’이다. HSUPA는

그동안 휴대폰용 베이스밴드 칩셋 시장에서는 ‘CDMA=퀄컴’ ‘GSM=TI’ 구도가 형성됐다. 물론 GSM계열 칩셋 업체로는 TI(텍사스인스트루먼트) 외 아기어·아날로그디바이스·ST 등 다수가 경쟁하고 있지만 시장의 50% 이상을 TI가 석권했다는 사실을 볼 때 이 회사의 독주를 의심할 사람은 없다. 그러나 이들에 당당히 도전장을 내민 업체가 있어 업계에서는 향후 판도 변화를 기대하고 있다. 대표적인 업체가 국내 베이스밴드칩 업계 양대산맥으로 불리는 이오빅스(www.eonex.com)와 VMTS(www.vmts.fr)이다.

글 | 김중을 기자

‘High-Speed Uplink Packet Access’의 약어로서 HSDPA(High-Speed Downlink Packet Access)가 ‘다운링크’에 무게를 두는 반면, HSUPA는 ‘업링크’ 속도를 올리는 기술로 구분된다. 업계에 따르면 현재 상향 최대 5Mbps 실현을 목적으로 3GPP의 ‘릴리즈 6’으로 도입이 예정돼 있다.

HSDPA와 HSUPA가 업계 최대 관심거리로 등장하면서 관련칩 업체들도 이에 대응하는 제품 출시에 만전을 기하고 있다. 현재 퀄컴 등 일부 메이저 반도체 회사들만이 제품 개발을 진행하고 있는 가운데 이오빅스가 내년 2분기 N4000으로 시장 공략을 자신했으니 이 회사를 바라보는 업계 시선에 놀라움이 배어 있는 것은 전혀 이상하지 않다.

VMTS

VMTS는 국내 휴대폰 업체인 브이케이가 지분 투자해 프랑스에 설립한 한국 벤처기업. 이동통신 분야 기반이 강한 프랑스에서 현지 연구인력 500여명 규모로 회사가 설립됐다. 이 회사는 최근 설립됐지만 지난 2분기 GSM/GPRS 휴대폰 단말기 베이스밴드 칩 및 핵심 소프트웨어인 프로토콜스택을 발표해 화제를 모았다.

현재 GSM/GPRS 솔루션이 양산되고 있다는 것은 VMTS의 숨은 실력을 잘 말해주고 있다. VMTS 솔루션이 채용된 최초 휴대폰은 올 4분기 유럽 시장에서 출시된다.

김상돈 대표는 “지금까지 대부분의 단말기용 베이스밴드칩은 하드웨어인 칩과 소프트웨어인 프로토콜 스택이 이원화된 형태로 제공돼왔다”며 “심지어 동일 회사의 이름으로 제공되는 칩 솔루션도 사업부가 칩과 소프트웨어로 이원화되고 물리적 거

리마저 멀리 떨어져 있어 사실상 서로 별개 회사인 셈이나 마찬가지였다”는 말로 업계 문제점을 지적하는 동시에 자사 강점을 설명했다.

이원화된 칩 솔루션에 문제가 발생할 경우 휴대폰 개발 업체들은 칩 업체와 소

프트웨어 업체를 따로 상대해야 했으며, 이는 제품 개발에 애로점으로 작용했다는 것.

VMTS는 칩과 소프트웨어를 같은 회사에서 동시에 제공하며, 번처의 이점 또한 살려 휴대폰 개발에 불필요한 요소를 줄여줄 수 있다고 자신했다.

VMTS는 한국 업체를 주요 고객으로 설정하고 있다. 자사가 한국 업체이기 때문이 아니라 그만큼 시장에서 한국 업체들이 열심히 활동하고 있기 때문이다.

현재 GSM/GPRS 솔루션을 양산하고 있는 VMTS는 내년 1월 EDGE 솔루션을, 내년 4분기 W-CDMA솔루션까지 양산하게 된다. VMTS가 출시를 예정하고 있는 W-CDMA 솔루션은 투칩 형태로 제공된다.

VMTS는 메이저 업체들에 비해 자사 솔루션을 30% 정도 저렴한 가격에 공급할 수 있을 것으로 전망하고 있다.

후발 업체이기 때문에 저렴한 가격을 무기로 내세우는 것이 아니라 메이저 업체들이 제품을 개발할 때 많은 중복 인력을 사용하는 반면 자사는 최적화된 인력과 구성으로 제품을 개발하기 때문이란 것이 VMTS의 논리이다. **K**

